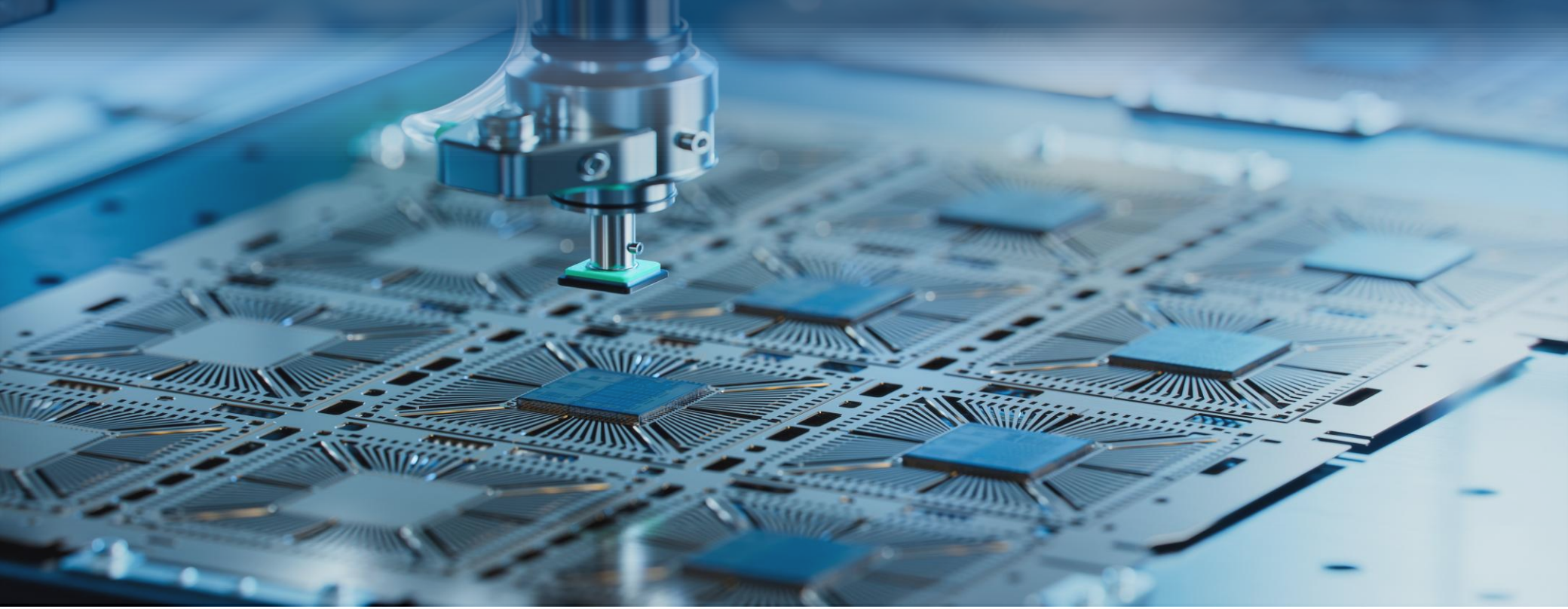


티엘비 2026년 3분기 경영실적 발표

2026.11.13

Thin Lamination Board
TLB

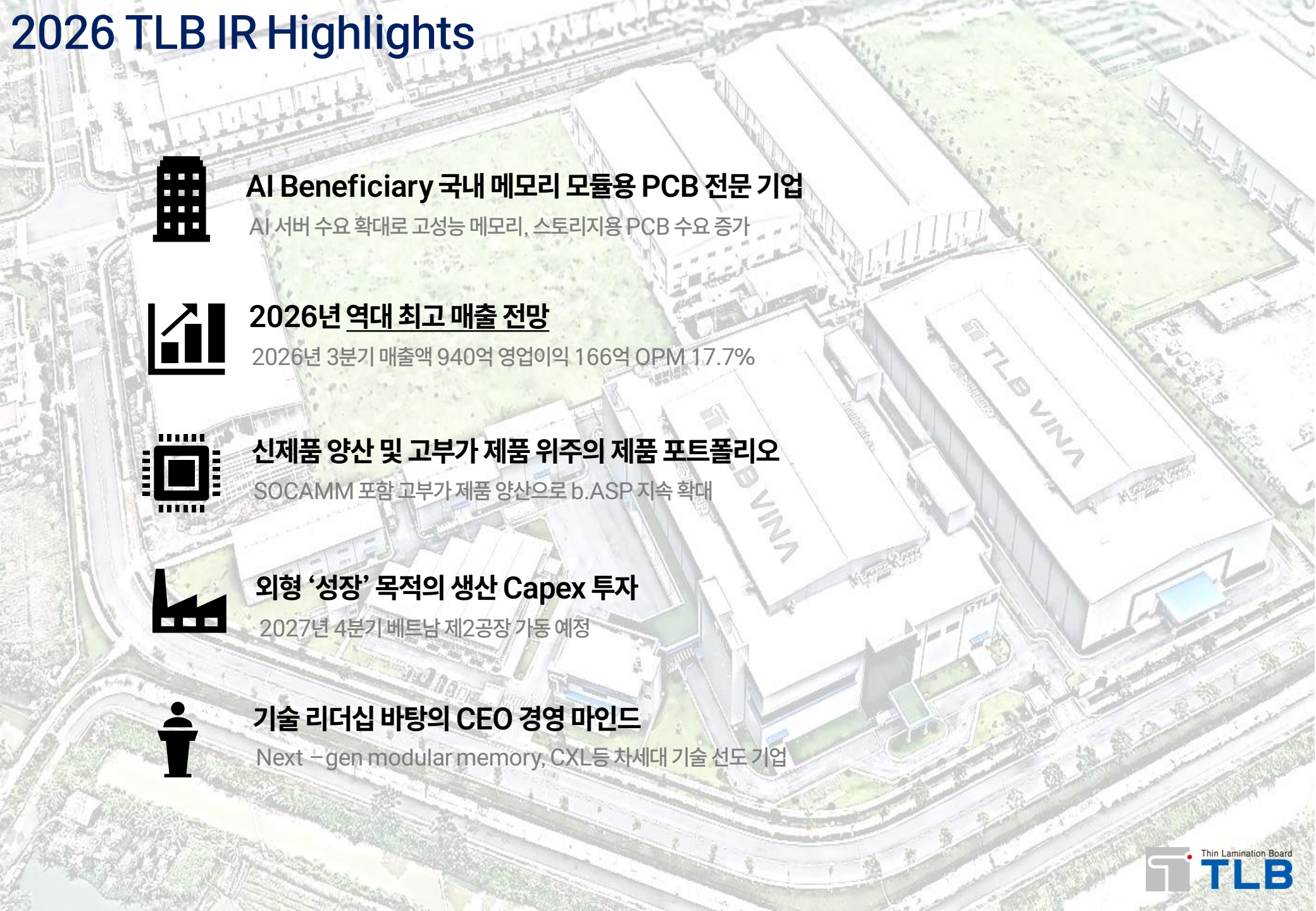
유의사항

본 자료는 투자자의 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 작성된 자료 입니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며,
문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

2026 TLB IR Highlights



AI Beneficiary 국내 메모리 모듈용 PCB 전문 기업

AI 서버 수요 확대로 고성능 메모리, 스토리지용 PCB 수요 증가

2026년 역대 최고 매출 전망

2026년 3분기 매출액 940억 영업이익 166억 OPM 17.7%

신제품 양산 및 고부가 제품 위주의 제품 포트폴리오

SOCAMM 포함 고부가 제품 양산으로 b.ASP 지속 확대

외형 '성장' 목적의 생산 Capex 투자

2027년 4분기 베트남 제2공장 가동 예정

기술 리더십 바탕의 CEO 경영 마인드

Next –gen modular memory, CXL등 차세대 기술 선도 기업

Thin Lamination Board TLB

티엘비의 미션

우리의 기술로 시작된 거대한 변화,

그 중심엔 Thin Lamination Board TLB 가 있습니다.

티엘비 성장현황 및 미래전략

TLB, We are...

기술 리더십 바탕의 **기업 가치 1조 기업**

- **기본정보**
  - **설립일 : 2011년 3월 25일**
  - **상장 : KOSDAQ (2020년 12월)**
  - **본사 : 경기도 안산시 단원구 신원로 305**
  - **대표이사 : 백성현**
- **사업영역**
  - **핵심 산업: 반도체 / 전자부품**
  - **주력 사업: 메모리 모듈용/SSD용 PCB**
- **규모 및 현황**
  - **연매출 : 2,585억 (2025년 기준)**
  - **임직원 : 800명**
  - **기업형태 : 중견기업**

2025~

티엘비 2.0 — 사업 고도화 해외투자

11년
- **06월 (주)티엘비 창립**

  11월 연구소 설립

20년
- **12월 티엘비 코스닥 상장**

21년
- **11월 베트남 해외 법인 설립**

23년
- 12월 은탑산업 훈장

24년
- **10월 VINA 공장 가동**
- 12월 안산 사무동 완공 및 입주 완료

티엘비 3.0 ~ — 해외 거점 확보 및 신제품 생산 본격화

25년
- 02월 AS9100 인증
- 04월 ESG 경영수준 확인서 A+ 등급 취득
- 09월 베트남 현지법인 투자 (Masslam 설비)
- 11월 안산2공장 매입

26년
- **01월 SOCAMM/LPCAMM 양산 진행**
- **2Q 안산 2공장 가동**

  VINA Masslam 설비 가동

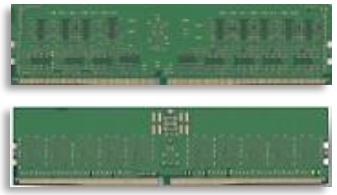
27년
- **4Q VINA 2공장 가동 예정**

티엘비 핵심 제품

지속적인 차세대 제품 개발·선점으로 시장 경쟁력 강화

Server Memory Module

- AI 데이터 센터와 같이 거대한 서버에 들어가는 메모리로, 안정성과 신뢰성이 높아 고부하 작업에 필수
- 단순한 저장공간이 아닌 무수히 많은 데이터를 처리하고 AI 연산에 필요한 정보를 정리

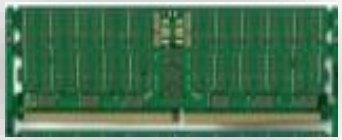


R-DIMM

DDR5 6400/7200 MT/s
DDR5 8000 MT/s

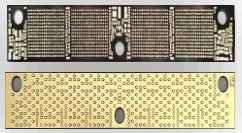
MR-DIMM(Multiplexed Rank DIMM)

여러 개 D램이 결합된 모듈 제품으로,
랭크(Rank) 2개 동시 작동으로 속도 향상



MR-DIMM은 데이터 버퍼를 이용해 랭크 2개를 동시에 작동시켜 대역폭을 R-DIMM 대비 두 배로 확장한 메모리로 기존 서버용 D램 대비 동작 속도는 80% 이상 향상되고, 높은 폼팩터를 적용한 제품

Next Gen. Modular Memory



SOCAMM

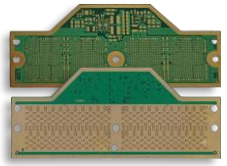
(Small Outline Compression Attached Memory Module)

디지털, 아날로그, 혼합 신호 회로를 하나의 칩에 집적해
소형 고성능 저전력을 구현한 제품

LPCAMM

(Low Power Compression Attached Memory Module)

LPDDR 기반의 새로운 폼팩터로
전력을 최소화하여 열 발생을 줄이는데 주로 사용





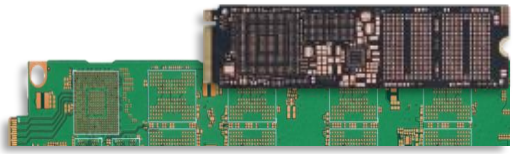
CXL(Compute Express Link)

지정된 CPU에 메모리 제공할 뿐만 아니라,
지정되지 않은 CPU에 메모리 확장한 제품

SSD

e-SSD

(Enterprise SSD)



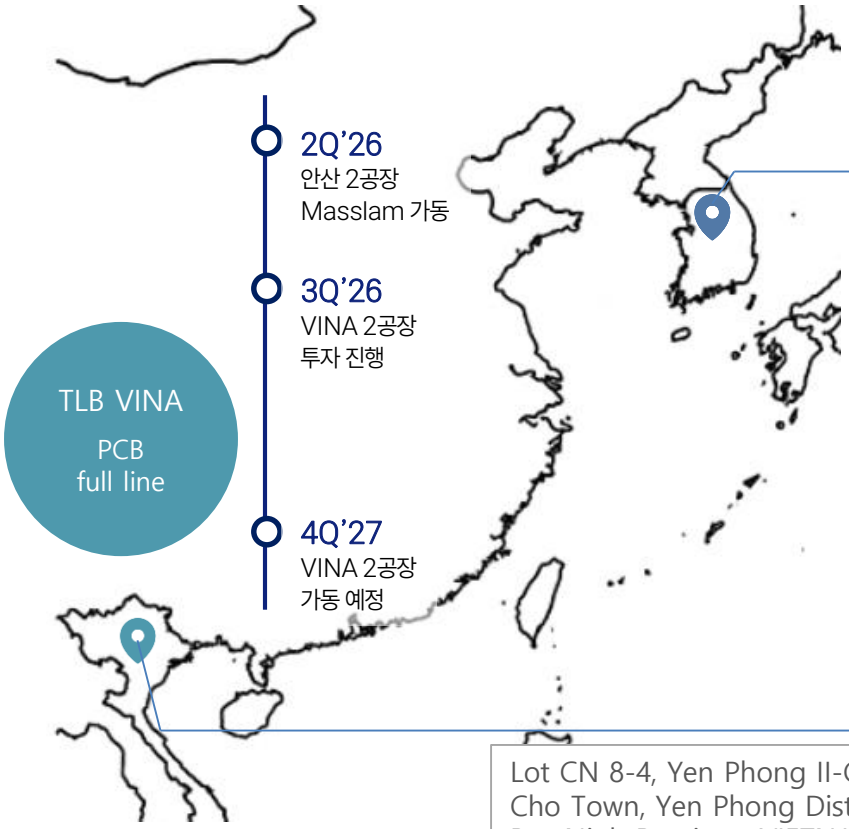
EDSFF

(Enterprise & Datacenter SSD Form Factor)

“티엘비 4.0”

시장 수요 및 신기술(다중적층 구조) 적용 추이를 선반영한 전략적 CAPEX 투자

(1) VINA 1공장 Masslam 설비 투자 (2) 안산 2공장 매입 (3) VINA 2공장 증설



TLB 본사 안산 1공장



16BL 17LT, 305 Sinwon-ro,
Danwon-gu, Ansan-si,
Gyeonggi-do, 15602, KOREA

TLB 안산 2공장



TLB VINA 1, 2공장



Lot CN 8-4, Yen Phong II-C IZ,
Cho Town, Yen Phong District,
Bac Ninh Province, VIETNAM

2026 3분기 실적 대시보드

매출액

940 억원

역대최고 QoQ ▲6.5%

영업이익

166 억원

역대최고 QoQ ▲29.9%

영업이익률

17.7 %

1Q'26 ▲ 14.1%, 2Q'26 ▲ 14.5%

(1) 6분기 연속 역대 최대 매출

2Q26 882억에서 3Q26 940억으로
2024년 3분기 매출 Turn Around 하여
최근 6분기 연속 최고 매출 기록

역대최고 QoQ ▲6.5% YoY ▲36.4%

(2) 가이던스 부합

영업이익 166억원, OPM 17.7%로
역대최고 영업이익 달성
3분기 가이던스 부합

QoQ ▲ 29.9% YoY ▲ 91.8%

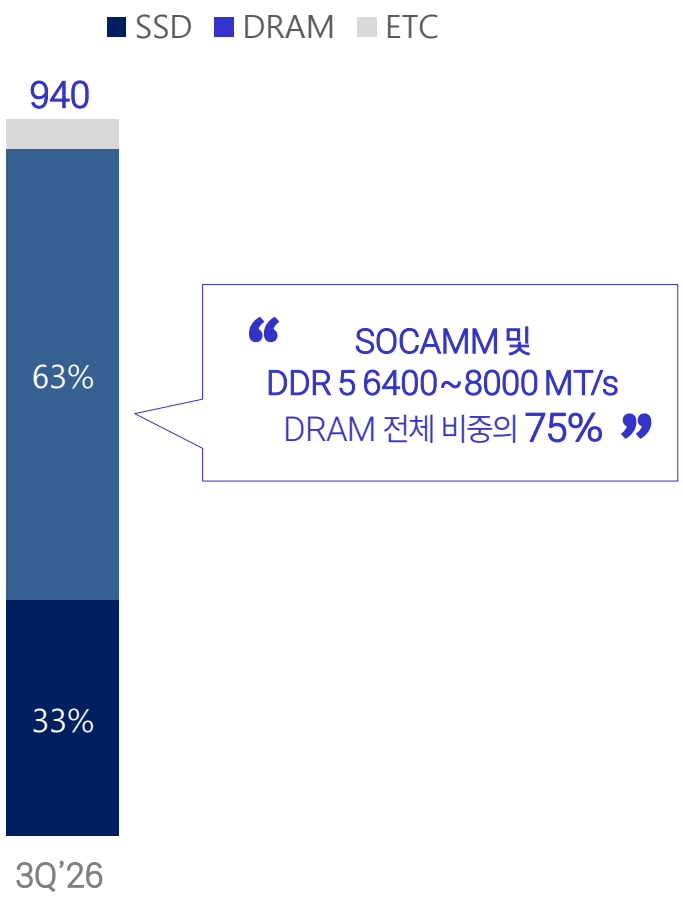
(3) 高부가 제품 중심 확대

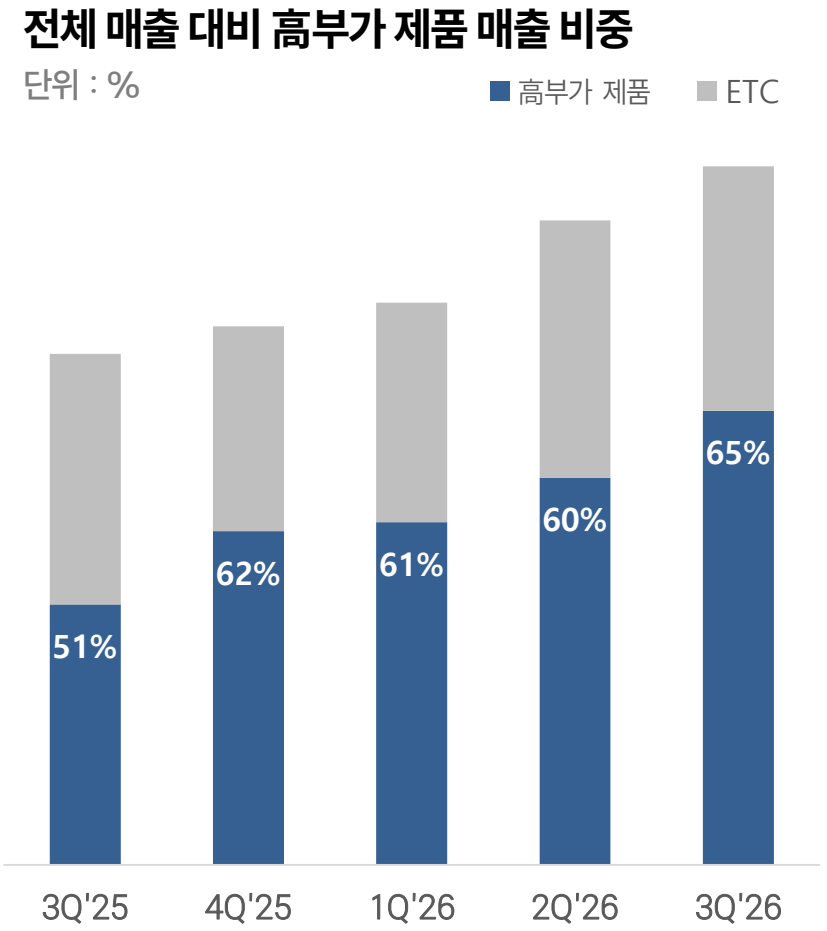
고부가 제품 매출 비중은 3Q'25부터
50% 초과하여 연속 4분기 60%대.
SOCAMM 비중 QoQ 대비 2배 ▲

역대최고 QoQ ▲5%p

2026 3Q 주요 제품 매출 구성

2026년 3Q 매출 비중은 DRAM 63%(SOCAMM 포함), SSD 33%, ETC 4%로 구성되어 있음
3Q SOCAMM 비중 QoQ 2배 이상▲, **전체 매출 대비 高부가 제품 매출 비중 역대 최고치 달성**





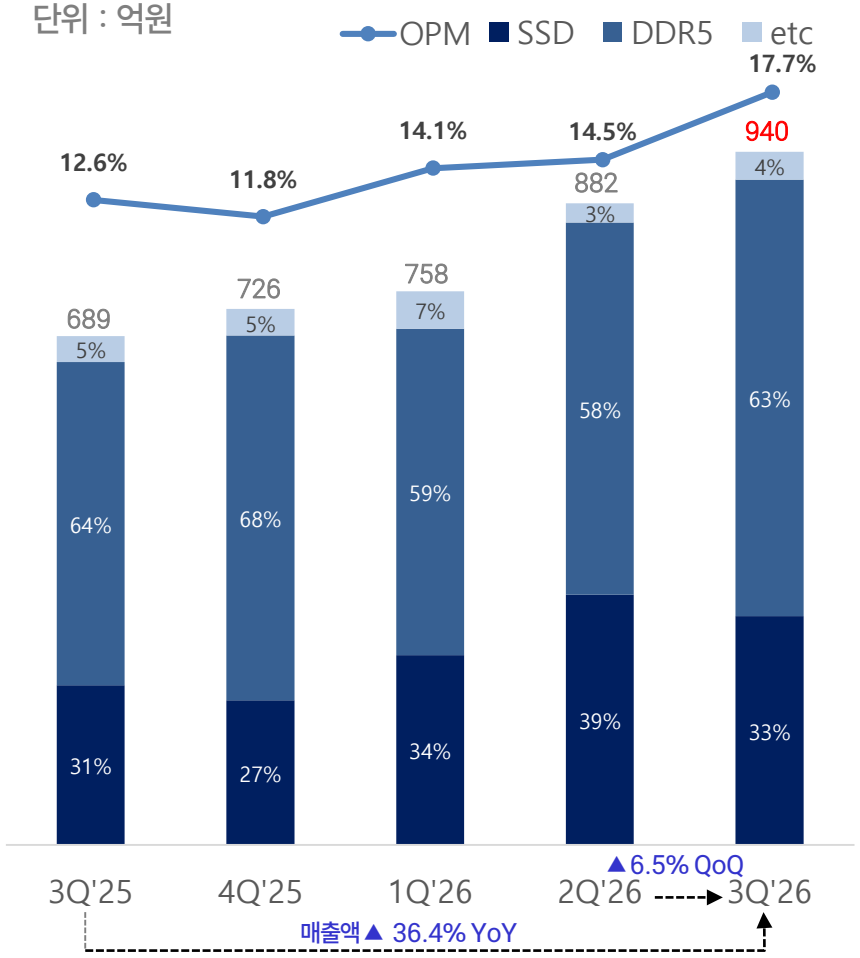
Thin Lamination Board TLB

2026년 3Q 경영성과

2026년 3Q 매출액은 **940억원**(▲ 6.5% QoQ, ▲ 36.4% YoY)으로 **6분기 연속 역대 최대 매출 기록**
영업이익은 **166억원**(▲26.7% QoQ, ▲86.2% YoY)으로 역대 최고치 경신, **OPM 17.7%**

분기별 매출

단위 : 억원



3Q26 현황

- 2분기 연속 역대 최고 수주 잔고 경신
- SOCAMM 비중 확대로 b.ASP 지속 상승
- .高부가 제품 비중 역대 최고치 달성

DRAM

SOCAMM 생산 및 매출 증가(QoQ 대비 2배▲)
Memory Module 비중 확대

SSD

높은 전방 수요로 인한 eSSD 생산 확대

4Q26 전망

- 최대 가동 도달 및 수주잔고 지속 확대
- SOCAMM 생산 및 매출 확대

Thin Lamination Board TLB

26년 3분기 경영실적 및 재무현황

요약 연결 손익 분석

(단위 : 억원)	2024	2025	3Q'25	2Q'26	3Q'26	QoQ	YoY
매출액	**1,800**	**2,585**	**689**	**882**	**940**	**58**	**251**
매출원가	1,659	2,203	569	710	734	24	175
매출총이익	**141**	**382**	**120**	**172**	**207**	**35**	**87**
판매비와관리비	107	123	33	44	41	(4)	8
영업이익	**34**	**260**	**87**	**128**	**166**	**38**	**79**
금융수익	7	5	1	1	12	11	11
금융비용	18	26	6	8	8	0	2
기타수익	34	32	6	21	6	(15)	0
기타비용	12	27	0	7	37	30	37
법인세차감전순이익	**49**	**244**	**87**	**134**	**138**	**4**	**51**
법인세비용	13	54	21	26	20	(6)	(1)
(당기)순이익	**36**	**189**	**65**	**108**	**118**	**10**	**53**

26년 3분기 경영실적 및 재무현황

요약 연결 재무 상태표

(기본 단위 : 억원)	3Q'25	2Q'26	3Q'26
자산총계	**2,248**	**2,754**	**4,168**
유동자산	1,170	1,126	2,341
현금 및 현금성 자산	365	117	190
매출채권	309	390	386
재고자산	378	534	610
부채총계	**1,040**	**1,307**	**1,400**
유동부채	947	991	1,110
자본총계	**1,207**	**1,447**	**2,768**
자본금	49	49	119
이익잉여금	1,098	1,188	1,259

주요 지표

	3Q'25	2Q'26	3Q'26
OPM	**12.6%**	**14.5%**	**17.7%**
GPM	**17.4%**	**19.5%**	**22%**
매출액 순이익률 (순이익/매출)	0.09	0.12	0.13
총자산 회전율 (매출/총자산)	1.23	1.28	0.90
재무 레버리지 (총자산/총자본)	1.86	1.90	1.51
부채 비율 (총부채/총자본)	0.86	0.90	0.51
자기자본비율 (총자본/총자산)	0.54	0.53	0.66
EBITDA 마진	**16%**	**17%**	**23%**

❖ 해당 보고서에 기재된 EBITDA 마진은 단일 분기 기준 수치임

Core Business Partners























경기도 안산시 단원구 신원로 305(목내동) 16BL 17LT
IR : purple@tlbpcb.com
www.tlbpcb.com